



PFR-600 B series

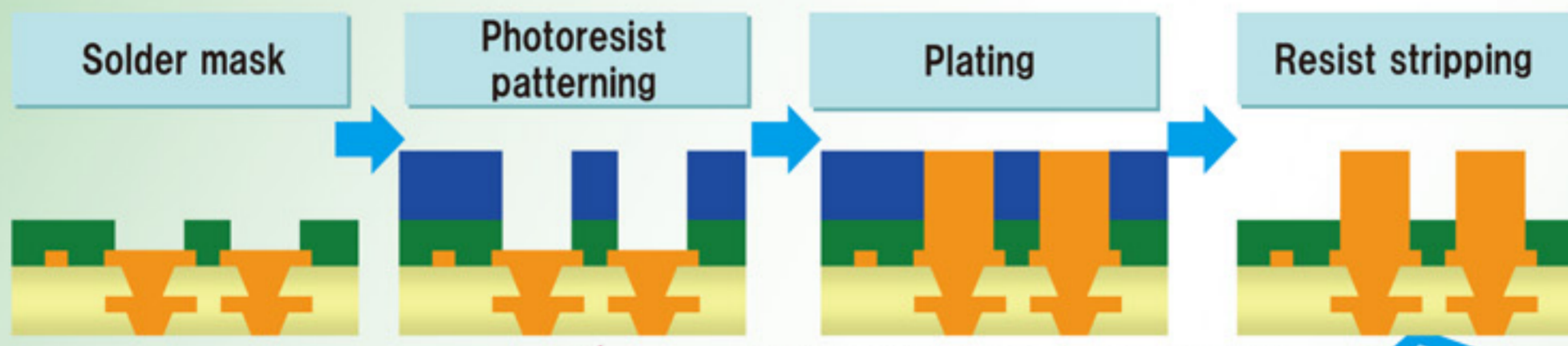
バンプ形成用ドライフィルムレジスト

Dry film photoresist for bump formation

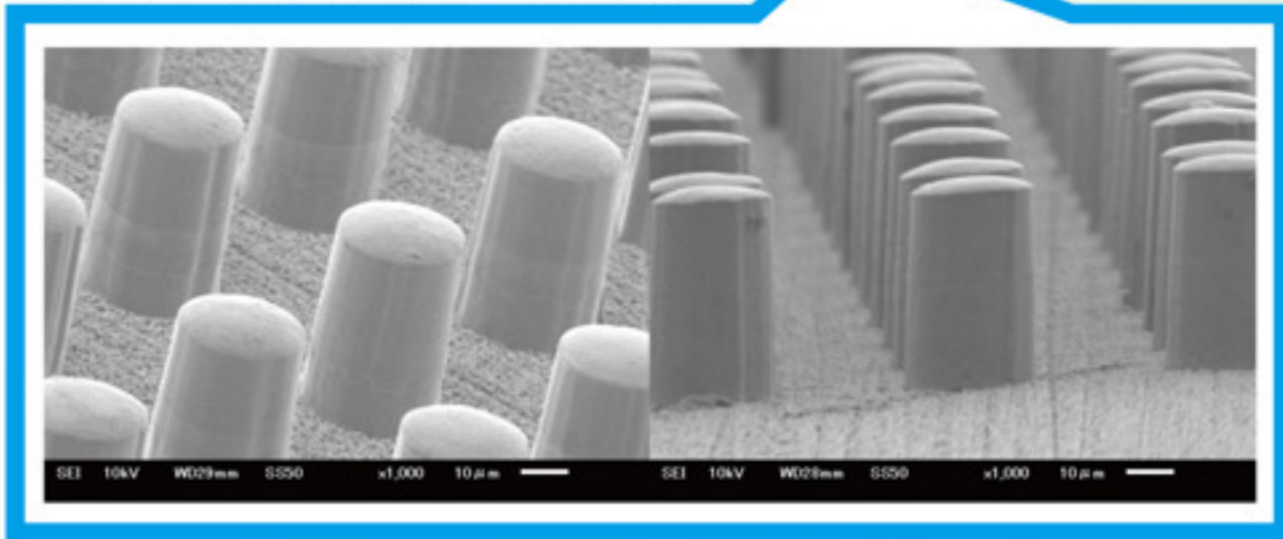
特徴 Features

- アルカリ現像 ネガ型感光性ドライフィルム Negative type, Aqueous developable dry film photoresist
- 高解像性 High Resolution
- めっきレジストとして使用可能 Suitable for plating resist applications
- アルカリ溶液で剥離可能 Easy stripping by alkali solution
- 様々な膜厚バリエーション (20 ~ 80um) Available in a variety of thickness (20 to 80 um)
- 常温保管 Available to store at room temperature

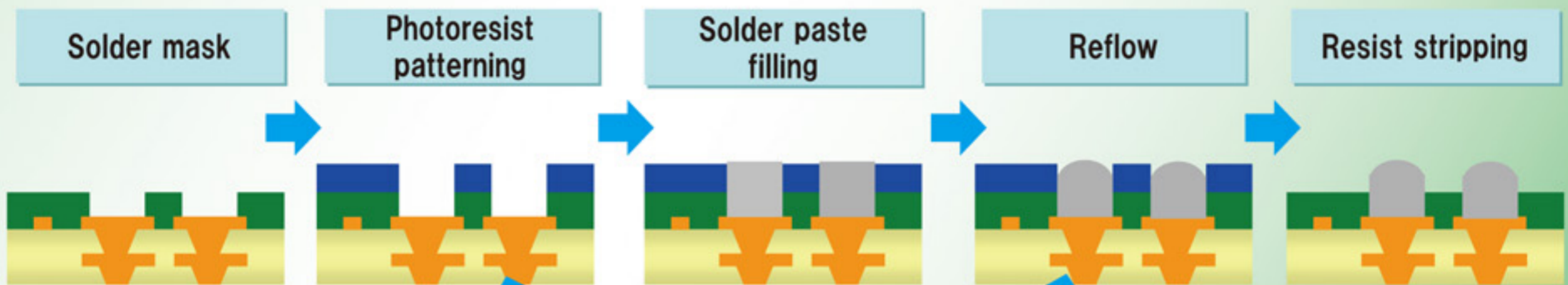
銅めっきバンプ形成工程 Process flow for copper bumping applications



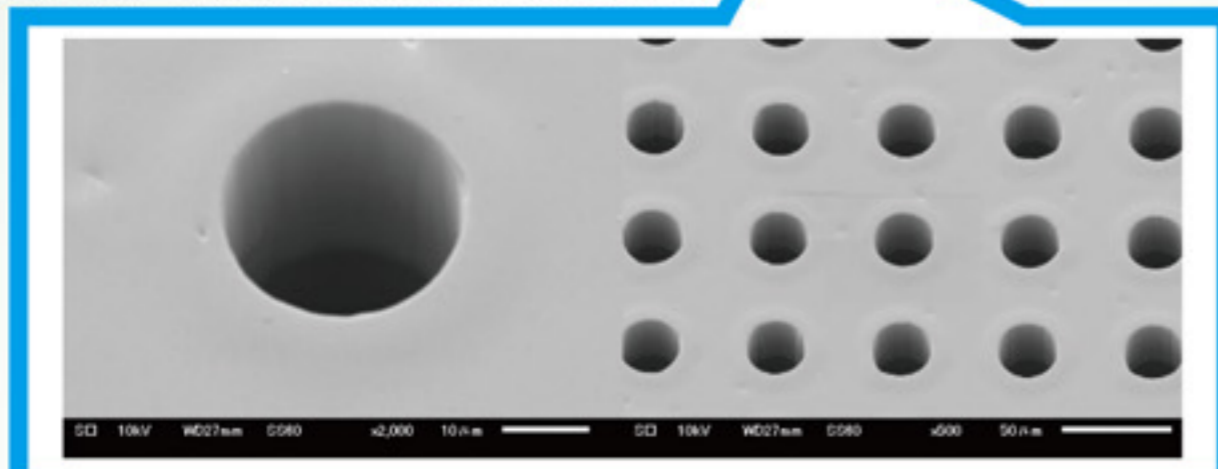
Φ30um Thickness 60um SEM観察写真



はんだバンプ形成工程 Process flow for solder bumping applications



Φ30um Thickness 30um SEM観察写真



Φ30um はんだリフロー後 SEM観察写真

